

工业智能产品开发方案 工业智能产品开发 北京一造电子

产品名称	工业智能产品开发方案 工业智能产品开发 北京一造电子
公司名称	北京一造电子技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市海淀区中关村大街49号9号楼5层B528
联系电话	13501395172

产品详情

硬件总体设计报告

以下内容由北京一造电子技术有限公司有限公司，为您提供服务，工业智能产品开发费用，希望对行业的朋友有所帮助。

硬件总体设计报告是根据需求说明书的要求进行总体设计后出的报告，它是硬件详细设计的依据。编写硬件总体设计报告应包含以下内容：系统总体结构及功能划分，系统逻辑框图、组成系统各功能模块的逻辑框图，电路结构图及单板组成，单板逻辑框图和电路结构图，以及可靠性、安全性、电磁兼容性讨论和硬件测试方案等。

单板总体设计方案

在单板的总体设计方案定下来之后应出这份文档，单板总体设计方案应包含单板版本号，工业智能产品开发，单板在整机中的位置、开发目的及主要功能，单板功能描述、单板逻辑框图及各功能模块说明，单板软件功能描述及功能模块划分、接口简单定义与相关板的关系，主要性能指标、功耗和采用标准。

想要了解更多一造电子技术相关信息，工业智能产品开发方案，欢迎拨打图片上的热线电话！

单板硬件详细设计

在单板硬件进入到详细设计阶段，应提交单板硬件详细设计报告。在单板硬件详细设计中应着重体现：单板逻辑框图及各功能模块详细说明，各功能模块实现方式、地址分配、控制方式、接口方式、存储器空间、中断方式、接口管脚信号详细定义、时序说明、性能指标、指示灯说明、外接线定义、可编程器件图、功能模块说明、原理图、详细物料清单以及单板测试、调试计划。有时候一块单板的硬件和软件分别由两个开发人员开发，因此这时候单板硬件详细设计便为软件设计者提供了一个详细的指导，因此单板硬件详细设计报告至关重要。尤其是地址分配、控制方式、接口方式、中断方式是编制单板软件的基础，一定要详细写出。

工业智能产品开发方案-工业智能产品开发-北京一造电子由北京一造电子技术有限公司提供。北京一造电子技术有限公司（www.zcir.net）拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！